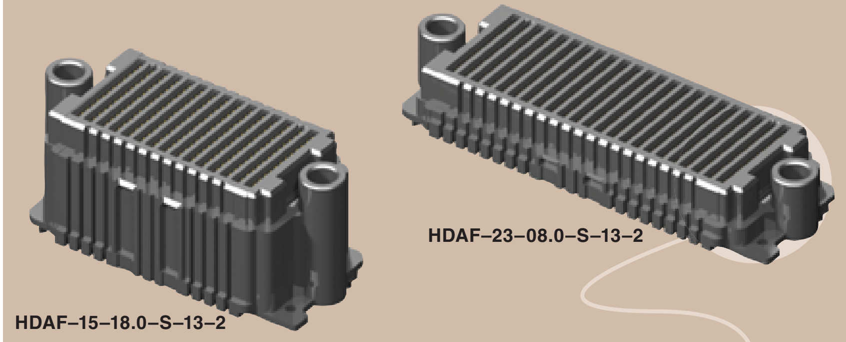
C-208T

samtec

HD MEZZ



HD MEZZ 加高式型矩陣 HDAF 系列

技術規格

如需了解所有規格以及所建議的 PCB 設計，請瀏覽 www.samtec.com?HDAF

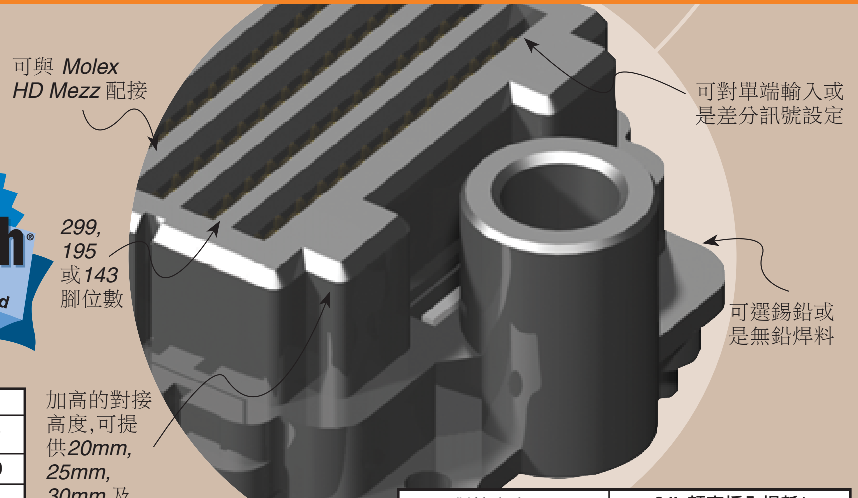
絕緣體材料：
黑色液晶聚合物
接觸面材料：
銅合金
額定電流：
2.3A @ 80°C 環境
工作溫度範圍：
-55°C 至 +125°C
電鍍：
鍍金或鍍錫
50µ" (1.27µm) 的鎳底
接觸面電阻：
19 mΩ 最大
工作電壓：
200 VAC
配對循環數：
100
符合 RoHS 標準:
是

加工：

最高加工溫度：
230°C 時 60 秒, 或
260°C 時 20 秒 3 次
無鉛回焊製程：
是

配對：
HDAM

Final Inch® Break Out Region Performance Certified finalinch.com



配對高度*		
HDAM 標定尺寸	HDAM 標定尺寸	
	–12.0	–17.0
–08.0	20mm	25mm
–18.0	30mm	35mm

*加工條件將影響配對高度.

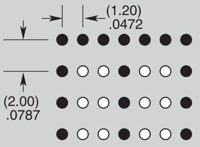
35mm對接高度	-3db 額定插入損耗*
單端訊號傳輸	9.0 GHz / 18.0 Gbps
差分訊號傳輸	9.0 GHz / 18.0 Gbps

*數據根據Final Inch® 設計模擬所得.

HDAF – 每排腳位數 – 標定尺寸 – 鍍層選項 – 排數 – 焊料類型 – 其它選項

- 每排腳位數：**–11, –15, –23**
- 標定尺寸：**請參考尺寸圖表**
- 鍍層選項：**–S** = 訊號接觸面鍍金 30µ" (0.76µm), 焊腳及焊接片鍍霧錫
- 排數：**–13**
- 焊料類型：**–2** = 無鉛錫合金焊料 (95.5%錫, 3.8%銀, 0.7%銅)
- 其它選項：**–P** = 取放盤

差分應用



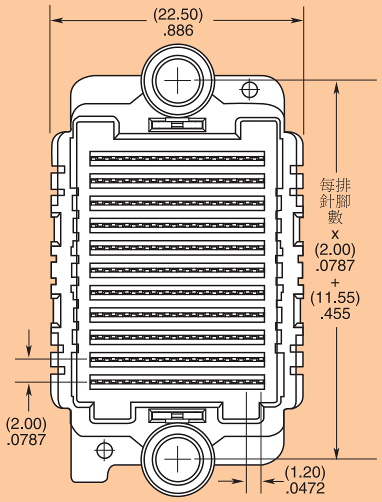
排列	對數*
11x13	44
15x13	60
23x13	92

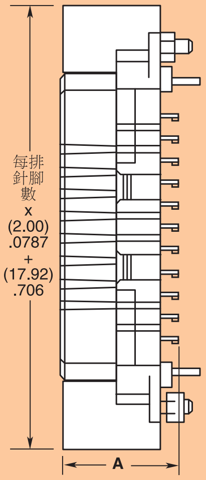
*2:1 S:G 比例

同時提供

錫-鉛銲接.
請致電 Samtec.

RUGGEDIZED by SAMTEC





標定尺寸	A
–08.0	(10.51) .414
–18.0	(20.51) .807

註：可與 Molex, Inc. HD Mezz 系列共用

註：HD Mezz 是 Molex, Inc. 的註冊商標

註：有些長度, 式樣和選件是非標準不可退換

因爲科技的發展，所有的設計、規格和部件如有更改，恕不另行通知。